

GLANZOX[®]

Silicon Polish



■GLANZOX

半導体デバイスの高集積化およびウェーファーサイズの大口径化が進むにつれて、シリコンの研磨面には、ナノボロジー対応を含めた、より高い平坦性、ダメージフリー、ヘイズフリー、重金属汚染フリーの完全鏡面が要求されています。これらの要求にお応えするために開発されたのがフジミグランゾックスシリーズです。コロイダルシリカを特殊組成液に分散させ、完璧な研磨面の実現を可能にしました。また近年、デバイス特性に影響する金属不純物についても厳しい低減要求がなされています。これに対し超高純度コロイダルシリカを開発し、さらに次元の高いポリシング材を用意しました。

■GLANZOX

With the increasing integration of semiconductor devices and the larger size of wafers, a damage-, haze- and heavy metal contamination free, flat, as well as nanotopography mirror-like silicon surface is essential. Fujimi's GLANZOX series was developed to meet such requirement. GLANZOX polish consists of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients. This product results in an almost perfectly polished surface. In response to the recent demand for considerable reductions in the metal impurities that affect device characteristics, higher-grades of polish containing ultra-pure colloidal silica have been developed.

GLANZOXの代表的物性 Typical Physical Properties of GLANZOX

項目 Item	製品名 Type	HP-20	1100
主成分 Main component		超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)		17.5	17.5
PH		11.4	11.5
比重 Specific gravity		1.11	1.10
平均粒子径 Average particle size (nm)		35	35
用途 Application		1次, 2次 For First and second polishing	1次, 2次 For First and second polishing
標準入数 Standard Net weight		20kg	20kg
ドラム Drum		220kg	—

項目 Item	製品名 Type	3900	3900RS	3950	3100
主成分 Main component		超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)		9.1	9.1	4.5	9.1
PH		10.5	10.5	10.8	10.3
比重 Specific gravity		1.05	1.05	1.03	1.05
平均粒子径 Average particle size (nm)		35	35	35	35
用途 Application		Final用 For final polishing	Final用 For final polishing	Final用 For final polishing	Final用 For final polishing
標準入数 Standard Net weight		10kg, 20kg	10kg	10kg	10kg
ドラム Drum		200kg	200kg	200kg	200kg